

深圳同兴达科技股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

（修订稿）

为把握发展机遇、提升公司核心竞争力、增强公司盈利能力，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“同兴达”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目	68,403.00	60,000.00
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		93,403.00	85,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

二、本次募集资金用于投资项目的的基本情况

（一）年产 6,000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目

1、项目基本情况

公司拟通过购进先进的生产设备新建异形全面屏二合一显示模组生产线，项目达产后将实现新增每年异形全面屏二合一显示模组 6,000 万片的生产能力，以达到提升公司的制程能力、产品质量控制能力和对下游客户及时配套供货能力的目的。

2、项目建设的背景

公司长期从事各种规格的中小尺寸液晶模组的生产销售，目前公司产品 90% 以上均应用于手机领域。从公司目前产品发展规划看，手机领域的显示模组开发依然是最主要市场。液晶显示模组作为工业中间品，行业权威统计数据难以取得，但由于公司产品主要应用于手机领域，同时每部手机通常配备一套液晶显示模组，因而公司所处的中小尺寸液晶显示模组市场需求与手机行业出货量存在对应关系，即手机市场出货总规模即为公司产品所处领域的市场总需求。

(1) 全球智能手机出货量长期处于较高水平

手机自 1973 年问世，从外形到功能均发生了翻天覆地的变化，现已成为人们生活、工作、学习、娱乐必备工具，2009 年以来全球智能手机按季出货量情况如下：

单位：百万



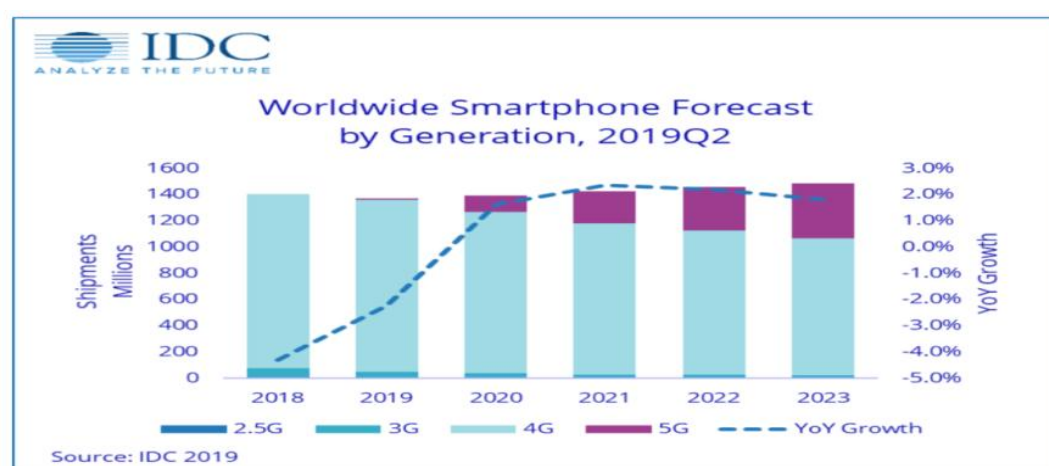
数据来源：IDC

2009年至2015年全球智能手机出货量逐年稳步增长,复合增长率为42.17%,2016年全球智能手机出货量实现历史新高,达14.73亿部,2017年-2019年,全球智能手机出货量分别为14.60亿部、14.07亿部和13.71亿部,相较于上年均有小幅下滑。

虽然智能手机市场增长放缓,但庞大的市场存量,仍确保了市场换机的巨大需求。未来一段时期,拉动智能手机出货量增长的动力表现为两个方面:

其一、5G通信技术带来“换机潮”需求。2019年6月6日,工信部正式下发5G商用牌照,5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合,为用户提供超高清视频、社交网络等加强虚拟现实的业务体验,促进人类交互方式的再次升级。5G的应用要求包括一系列不同的频谱、技术和方法,以及全新的无线网络建设方法,同时带来对智能手机的全新要求,5G手机将发生重大变化,随着未来5G网络的推广和5G手机的进一步渗透,智能手机将迎来一波巨量“换机潮”。2019年7月-10月,华为、中兴、三星、小米、vivo等已陆续发布其首款5G手机。

其二、新兴市场手机需求空间依然广阔。目前,智能手机在经济较为发达地区已基本普及,但在印度、东南亚、非洲等新兴市场,智能手机市场需求还有较大空间。据IDC统计,2019年印度智能手机出货量约为1.525亿部,同比增长8%,成为全球智能手机增长最快的市场。



受益于庞大存量市场带来的“存量换机需求”、“5G 手机增量需求”、“新兴市场手机消费升级需求”等因素叠加,全球智能手机出货量保持高位运转态势,从而为公司显示模组提供稳定、等量的巨大市场需求。

（2）国内手机厂商的全球市场份额稳步提升

2018 年以来，全球智能手机市场发展有所放缓，但市场内部竞争激烈，以“HMOV”为代表的国内手机厂商份额逆势增长，苹果下滑较为明显。全球智能手机的市场集中度有较大幅度提高，前六名厂商的市场份额接近 80%。

单位：亿部

厂商	2019 年		2018 年		2017 年	
	出货量	市场份额	出货量	市场份额	出货量	市场份额
三星	2.96	21.59%	2.9	20.57%	3.2	21.92%
华为	2.41	17.58%	2.1	14.89%	1.5	10.27%
苹果	1.91	13.93%	2.25	15.96%	2.34	16.03%
小米	1.26	9.19%	1.2	8.51%	0.9	6.16%
OPPO	1.14	8.32%	1.2	8.51%	1.2	8.22%
其他	4.04	29.47%	4.45	31.56%	5.46	37.40%
合计	13.71	100.00%	14.1	100.00%	14.6	100.00%

数据来源：IHS、IDC 等

（3）两类产品开发模式长期并存于手机厂商

目前除苹果以外，全球大部分品牌手机厂商均采用两类并行的产品开发模式：

其一、外研模式（ODM）。手机方案厂商深度参与其产品研发并组织生产。手机成品交付之后，通过自有品牌及渠道对外销售。

其二、内研模式。手机厂商独立实施产品研发、组织物料采购、自建产线生产，通过自有品牌及渠道对外销售。

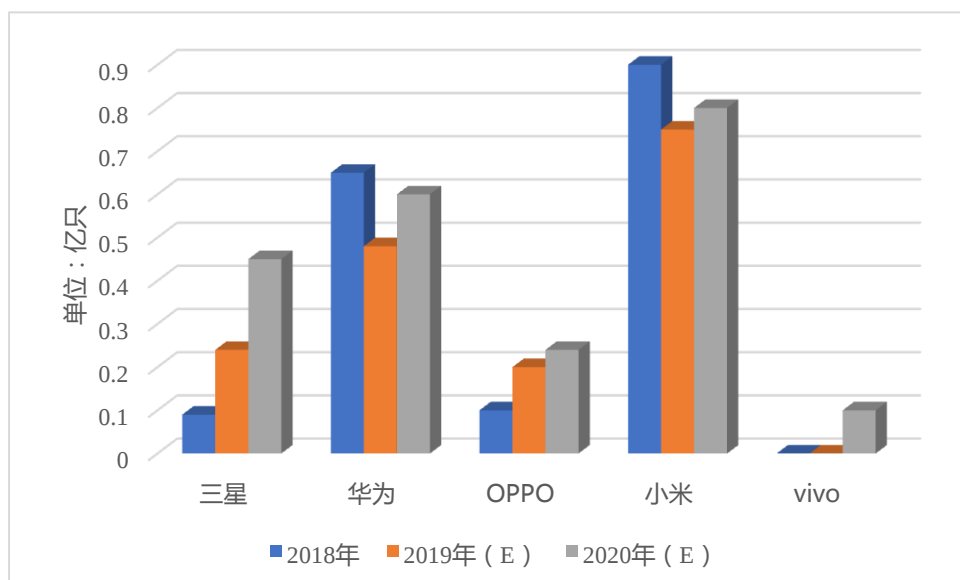
全球主要手机厂商 ODM 情况如下：

手机厂商	ODM 比例			主要手机方案商	备注
	2018	2019E	2020E		
三星	3%	8%	15%	闻泰	2018 年首次尝试 ODM 并获得巨大成功，未来三星将加大 ODM 机型的出货，尤其在海外市场
华为	32%	18%	20%	华勤、闻泰、龙旗、中诺	2018 年收缩 ODM 项目出货机型，但未来也会保持在 20%的比例
小米	75%	75%	75%	闻泰、华勤、龙旗	始终保持较高 ODM 机型出货比例

OPPO	9%	18%	20%	闻泰、华勤	ODM 机型出货量逐年增加，未来会维持在 30%的水平
VIVO	0%	0%	10%	-	2020 年预计将采用 ODM 机型，尤其海外市场

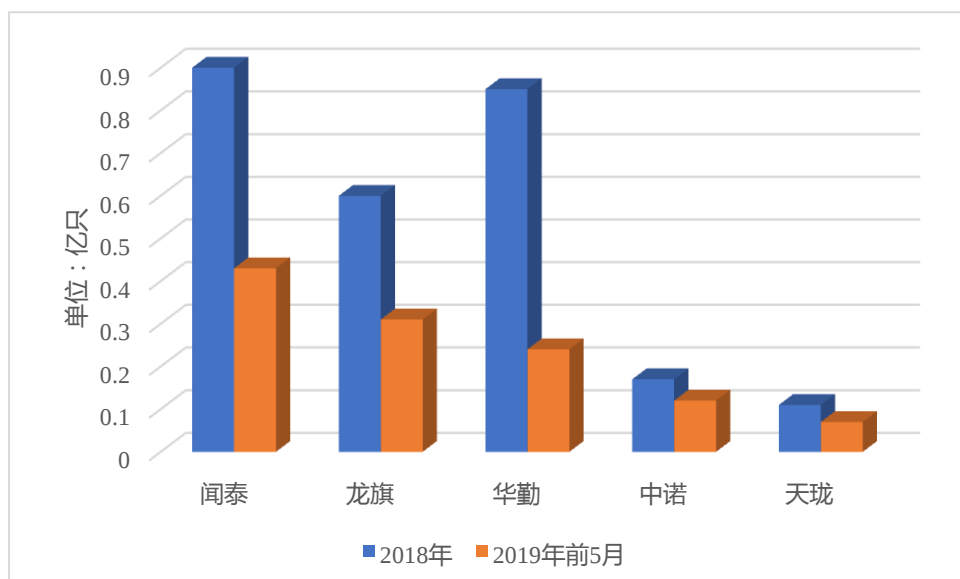
数据来源：IHS 等

全球主要手机厂商 ODM 机型出货量如下：



数据来源：IHS 等

2018 年以来，各 ODM 厂商出货量如下：



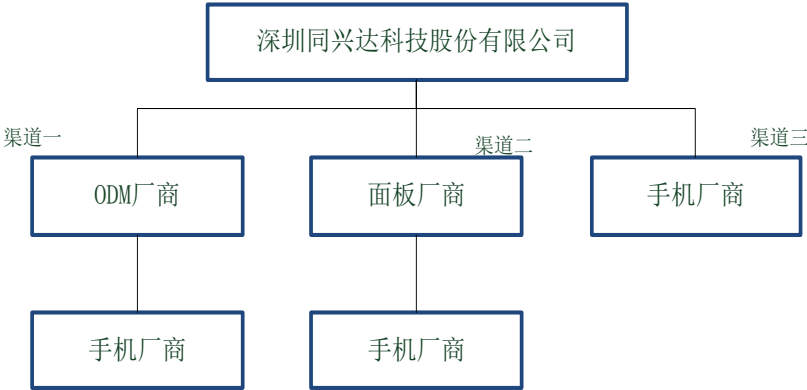
数据来源：IHS 等

经过多年市场充分竞争，手机 ODM 行业的市场集中度大幅提升。从 2018 年各 ODM 厂商出货量看，前三大 ODM 厂商（闻泰、华勤、龙旗）合计出货量

高达 2.35 亿部，市场份额合计 86.6%，行业寡头垄断格局初显。

(4) 公司已建立起全方位客户合作体系

经过多年市场耕耘，公司建立起全方位客户合作体系，与产业链各主要厂商均形成稳定合作关系。公司手机显示模组销售路径如下：



上述销售渠道流转主要如下：

渠道一、公司与手机厂商经协商，由手机厂商指定的 ODM 厂商向公司下达产品采购订单，公司向 ODM 厂商交付产品；

渠道二、手机厂商首先向面板厂下达模组采购；后经协商，面板厂转移订单，由公司向该面板厂采购面板并加工为显示模组，最后由面板厂交付产品给手机厂商；

渠道三、公司接受手机厂商订单需求，按照要求采购核心原材料，组织产品生产和交付。

上述各渠道流转过程中，公司需取得双重认证：其一、手机厂商资格认证；其二、ODM 厂商或面板厂商资格认证。公司销售环节主要合作对象如下：

公司主要合作的 ODM 厂商	 WINGTECH PROFESSIONAL SOLUTIONS 闻泰科技	 HUAQIN 华勤通讯	 LONGCHEER 龙旗控股
公司主要合作的面板厂商	 京东方 BOE	 INNOLUX 群創光電股份有限公司	 TIANMA
公司产品应用的主要手机厂商	 HUAWEI	 SAMSUNG	 mi
		 TCL	 vivo
			 lenovo 联想

	TECNO	OPPO
--	-------	------

2019 年，公司源自于“HMOV”及三星的手机终端销售占比在 60%左右；公司与主要 ODM 厂商（闻泰、华勤、龙旗）保持多年深度合作；此外，公司还与全球主流面板厂均保持了良好的合作关系。公司已建立起全方位客户合作体系，为主营业务收入快速增长打下良好基础。

（5）公司已完成生产基地的全面布局

公司现已完成生产制造基地的全面布局，国内方面，公司拥有赣州和南昌两个生产基地，具有较强的交付能力，能够满足客户采购需求；海外方面，公司已在印度建立生产基地，并已成功实现量产，这不仅提高了公司的海外及时交货能力，而且使公司可以有效规避中美贸易摩擦所带来的诸多风险，还使公司可以充分利用印度较低的人工成本，获得成本优势。

3、项目建设的必要性

（1）手机的不断演进倒逼模组厂商同步改进工艺，持续增加设备投入

随着科技的进步和人们需求的提升，手机在功能、形态、尺寸、分辨率等方面不断演进，倒逼上游供应链厂商同步更新工艺，持续增加设备投入。公司作为国内主要显示模组厂商，多年来紧随下游变化，资本投入逐年增加，单位产线投资额已从 2012 年的 200 万元左右上涨至当前的 6,500 万元左右，客户结构不断优化，目前已基本覆盖全球主要手机品牌厂商和 ODM 厂商，为持续满足客户需求，公司必须继续提升工艺水平，进行大量设备投入；同时，随着智能手机向“真全面屏”（100%屏占比、隐藏摄像头）乃至折叠屏、环绕屏的进一步进化，以及 5G 技术对智能手机的全新要求，将会对显示模组厂商的资本实力提出更高的要求。公司仅仅依靠自身积累和间接融资难以完全满足业务规模扩大与新工艺新设备的资金需求，因而需通过本次非公开发行进行融资以获取资金支持，本次非公开发行具有充分的必要性和紧迫性。

随着手机演进，公司历年来因改进生产工艺实施的设备投入及主要客户变动情况如下：

手机分类	主要年份	手机演进情况	公司核心生产设备	单位产线投资额	公司主要服务的终端客户
------	------	--------	----------	---------	-------------

手机分类	主要年份	手机演进情况	公司核心生产设备	单位产线投资额	公司主要服务的终端客户
功 能 机 时 期	2012 年之前		切割机、贴片机、半自动 COG 机、手动 FOG 机	200 万左右	国内 2 线手机品牌
智 能 机 时 期	2012 年至 2014 年		切割机、贴片机、全自动 COG 机、半自动 FOG 机、半自动背光组装机	500 万左右	中兴、TCL、HTC、传音、Micromax、LAVA
	2015 年至 2016 年		切割机、贴片机、全自动 COG 机、全自动 FOG 机、全自动背光组装机、OCA 贴合机	1,500 左右	华为、中兴、TCL、联想、酷派、HTC、传音、Micromax 、 LAVA 、INTEX、诺基亚、LG、朵唯、魅族
全 面 屏 时 期	2017 年 Q1-Q2		异形切割机、贴片机、全自动 COG 机、全自动 FOG 机、全自动背光组装机、OCA 贴合机、OTP 机、AOI 设备	3,500 万左右	华 为 、 T C L 、 联 想 /MOTO、传音、诺基亚、LG、魅族、海信
	2017 年 Q3-Q4		异形切割机、贴片机、全自动 COG 机、全自动 FOG 机、全自动背光组装机、OCA 贴合机、OTP 机、AOI 设备、激光切割机、CNC 切割机	5,000 万左右	
	2018 年				华 为 、 T C L 、 联 想 /MOTO、传音、LG、三星、OPPO、vivo、小米
	2019 年		异形切割机、贴片机、全自动 COG 机、全自动 FOG 机、全自动背光组装机、		

手机分类	主要年份	手机演进情况	公司核心生产设备	单位产线投资额	公司主要服务的终端客户
			OCA 贴合机、OTP 机、AOI 设备、激光切割机、CNC 切割机、COF 设备、盲孔封胶设备		

(2) 全面屏已成为智能手机市场主流，公司亟需提升全面屏的制程和出货能力

随着面板技术的不断进步，手机屏幕尺寸提升已达极限，除了显示材料的升级以外，高屏占比（全面屏）脱颖而出。全面屏通常是指真实屏占比可以达到 80% 以上，拥有超窄边框设计的智能手机。全面屏从高像素和大视野两方面给予消费者更佳的视觉体验，现已成为智能手机市场的主流。主要手机厂商华为、苹果、三星、小米、vivo、OPPO 等都已在自己的主要产品中应用了全面屏，并向中低端机型不断渗透，市场前景广大，根据 CINNO Research 的统计，2017 年全面屏在智能机市场的渗透率仅为 6%，2018 年约为 50% 左右，2021 年将增长至 93%。

全面屏手机要求对显示面板进行精度极高的异形切割、打磨和贴片组装，同时全面屏又有不同的实现方案，包括刘海屏、水滴屏、挖孔屏、双屏、滑盖屏、机械升降等，不同的方案对设备工艺的要求又不尽相同，从而对显示模组厂商的制程能力、工艺水平提出了革命性的改变。通过募投项目的实施，公司能够提升全面屏的制程能力和出货能力，满足多种全面屏方案的加工要求，生产符合市场需求的领先性产品，从而把握行业发展趋势，推动公司的快速发展，增强公司的市场地位，本次非公开发行具有必要性。

(3) 本次募投项目是提升公司生产能力，增强公司盈利水平的重要举措

智能手机显示、触控一体化集成度高的趋势，不仅对模组厂的生产技术提高了要求，同时亦对模组厂及时交付能力提出了更高的要求。本项目实施达产后将在现有产能基础上每年新增高端产能 6,000 万片，极大的提升对客户的及时交付能力。

同时，本项目的实施将推动公司生产流程、生产硬件设备全面升级，实现工业 4.0 下的智慧工厂建设，全面满足全面屏模组产品特性要求。项目实施后，公

司设备的智能化程度高、精度高、关键工序带 AOI 自动检测功能，并可以达到全程无人员接触产品，对质检人员的依赖性降低，质量保障成本降低，提升高端产品的质量保障度、良率稳定性，极大改善产品的微观问题、可靠性问题。此外，全自动生产线的建设，其意味着大大减少直接人力，有效规避未来缺工问题，降低运营成本，有利于提升公司的成本控制能力，加之升级后的高端产能由于其技术附加值更大，产品售价、利润更高，从而在满足未来行业发展趋势的同时，将提高公司的盈利水平。

4、项目建设的可行性

（1）政策可行性

TFT-LCD 模组作为我国电子信息产业中一部分，受到国家的高度重视，《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中明确指出将“信息产业中的薄膜场效应管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”列为国家鼓励目录；《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用，推动半导体显示产业链协同创新。围绕 TFT-LCD 模组，国家出台了一系列相关的规划，如《通信业“十三五”规划》、《电子基础材料“十二五”规划》、《电子信息制造业“十二五”规划》，明确将 TFT-LCD 产品及相关产业作为其重点发展内容；《重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）》中将 TFT-LCD 设备作为其重要发展的一项重要，同时强调要加强产品生产工艺及设备的稳定性。国家产业政策的支持为公司稳定的发展提供了良好的政策环境。

（2）市场可行性

根据 IDC 统计数据，2015-2018 年，全球智能手机出货量均保持在 14 亿部以上的较高水平。随着 5G 移动通信系统的建设与普及带来的换机潮、用户数量增长、新兴市场的发展以及全面屏手机渗透率提升的带动，将进一步拉动智能手机的需求。全面屏作为未来行业主要发展方向之一，渗透率将逐渐上升，根据 CINNO Research 的统计，2017 年全面屏在智能机市场的渗透率为 6%，2018 年约为 50%左右，2021 年将增长至 93%，全面屏手机未来市场容量较大。本项目

通过购进生产设备建设年产 6,000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目，项目达产后在现有产能基础上新增高端产能 6,000 万片/每年，随着全面屏手机的进一步普及，目标市场完全有能力消化该部分产能。

(3) 技术可行性

公司是国内较早从事 TFT-LCM 研发、生产和销售的主要企业之一，经过多年的发展，产品设计开发水平、产品生产工艺水平在行业内处于领先地位，公司所产产品经过多项检测环节，保证了产品品质的稳定性，已成为全球主要手机制造商的重要供应商。经过多年的市场积累，公司形成了一套能够适应市场快速发展及变化的生产工艺，保证了产品生产技术的稳定性。综上所述，本项目具有技术可行性。

(4) 人才可行性

经过多年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才储备机制。自创立之初公司就十分注重人才的内部培养，并用合理的待遇、良好的机制、良好的企业文化吸引优秀的管理人才和研发人才加盟，公司践行“能者上、庸者下”的晋升机制，培养员工成为相关领域熟手乃至专家，在市场营销、技术研发、生产管理、品质管理、材料采购等诸多关键的经营环节均打造出一支忠诚可靠、专业过硬的团队。公司核心管理层均从业多年，同行业工作经验平均约 14 年，长期专注于电子行业，具备丰富的管理经验和专业知识，能够有效的组织公司的高效运营；在研发创新方面，公司设有研发中心部，负责新产品开发，并使之顺利导入量产，同时对生产提供技术支持，推动产品品质的改善，这些人员均具有丰富的产品技术标准方面的专业理论知识和实践操作经验，技术素质较高。

公司对本项目的启动做了充分的人才准备工作，包括管理人才和专业技术人才，以保证本项目的顺利实施，本项目具备人才可行性。

5、项目投资概况

本项目总投资额为 68,403.00 万元，拟使用募集资金金额为 60,000.00 万元。

6、项目实施主体及实施地点

本项目拟由赣州市同兴达电子科技有限公司负责实施。实施地点为赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南，赣州市同兴达电子科技有限公司已取得相应的土地使用权，所涉及的土地使用证编号为赣市开国用[2014]第 31 号。

7、项目建设期

本项目建设期为 24 个月。

8、项目经济效益测算

综合经济分析表明，该项目税后财务内部收益率 17.59%，税后投资回收期 6.94 年（含建设期 2 年），具有较好的经济效益和社会效益。

9、项目备案与环境保护评估情况

截至本公告日，该募投项目已完成江西省投资项目备案，项目代码：2018-360799-39-03-031914，并且取得赣州市环境保护局开发区分局出具的赣市环开发[2019]19 号环评批复。

（二）补充流动资金

公司募集资金扣除发行费用后，除用于年产 6,000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目外，还将用于补充流动资金，以增强公司营运资金实力，加强公司在液晶显示模组行业的竞争优势。

1、项目概况

拟将本次非公开发行股票募集资金 25,000.00 万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、优化财务结构、增强公司市场竞争力。

2、补充流动资金的必要性及对公司的影响

（1）公司经营模式的需要

公司产品从原材料采购、生产制造到客户提货并支付款项，平均周期为 110 天左右，在此过程中需要公司垫付大量流动资金用于生产经营，流动资金不足将导致相关的工作程序无法开展，从而限制公司的生产规模进一步扩张。

（2）改善公司财务状况需要

公司资产基本为流动资产，2017-2019 年公司流动资产占总资产比保持在 80% 以上。公司营业收入增长一般需要配备较高的流动资产，2017-2018 年，公司经营性流动资产占收入比在 62% 左右。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 76.64%，虽然目前公司运转良好，能及时偿付经营性负债，从未因偿债能力不足而拖欠供应商或出票银行款项，但长时间较高的资产负债率将影响公司的经营安全。因此，补充流动资金能有效降低公司经营风险，增强公司抗风险能力，实现公司长期持续稳定发展。

（3）公司业务规模扩张需要合理规模的流动资金支持

随着公司销售规模的快速发展，公司需要较大的营运资金支持生产周转与营销服务。目前，公司产品主要应用方向为智能手机，随着经济条件的不断改善、新兴市场的增长、全面屏手机的进一步渗透，以及 2020 年 5G 网络商用带来的“换机潮”，保证了智能手机市场巨大的需求量。公司营业收入规模随之扩大，营运资金缺口也将加大。

公司未来营运资金的需求与公司营业收入的增长速度密切相关，营业收入增长速度越快，公司对营运资金的需求量越大。近年来，公司业务保持高速发展态势，营业收入逐年较大幅度递增，促使公司将面临较大营运资金缺口。对营运资金的需求随之增加，为了保障公司具备充足的资金以满足主营业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，公司拟通过本次非公开发行募集资金补充流动资金。

三、本次非公开发行对公司经营管理及财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，增加公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开股票的发行将进一步扩大公司的资产规模，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均会有所增长，公司的资产负债率将有所降低。本次募集资金将会得到有效使用，通

过募投项目的顺利实施，项目效益的逐步释放将为公司和投资者带来较好的投资收益，从而促进公司健康发展。

四、结论

综上所述，公司本次非公开发行股票符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来良好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司生产经营规模，提升公司生产经营效率，促进公司的持续发展，增强公司的竞争力。本次非公开发行募集资金的运用合理可行，符合公司及公司全体股东的利益。

（以下无正文）

深圳同兴达科技股份有限公司董事会

2020年3月17日